

证券代码：002916

证券简称：深南电路

深南电路股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2023-15

<p>投资者关系活动类别</p>	<p> <input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（<u>券商策略会</u>） </p>
<p>参与单位名称及人员姓名（排名不分先后）</p>	<p> 浙商证券、财通证券、UBS 瑞银证券、德邦证券、兴业基金、兴全基金、信达澳亚基金、景顺长城基金、盈峰资本、GIC、UG Investment、HSBC Global Asset Mgmt (UK)、Rosefinch Fund、Brilliance Asset Mgmt、Golden Nest Capital Mgmt、Grand Alliance Asset Mgmt、Luven Capital Mgmt Ltd、Luxence Capital Ltd、Pleiad Investment Advisors、Sumitomo Mitsui DS Asset Mgmt、APG Asset Mgmt、Point72、AllianceBernstein LP、T. Rowe Price Associates Inc、INFINITE、Neo Criterion Capital、Pinpoint Asset Mgmt Ltd、Polymer Capital Mgmt、Nomura Asset Mgmt、Barings LLC、Millennium Partners </p>
<p>时间</p>	<p>2023 年 8 月 28 日 - 8 月 30 日</p>
<p>地点</p>	<p>电话及网络会议；UBS 瑞银策略会（深圳）；德邦证券策略会（深圳）</p>
<p>上市公司接待人员姓名</p>	<p> 副总经理、董事会秘书：张丽君；战略发展部总监、证券事务代表：谢丹； 投资者关系经理：郭家旭 </p>
<p>投资者关系活动主要内容介绍</p>	<p> 交流主要内容： Q1、请介绍公司 2023 年半年度经营业绩情况。 2023 年上半年，在外部环境复杂多变的情况下，整个电子信息产业受经济环境影响较为显著，行业整体需求有所承压。公司报告期内实现营业总收入 60.34 亿元，同比下滑 13.45%，归母净利润 4.74 亿元，同比下降 37.02%。上述变动主要受公司 PCB 及封装基板业务下游市场需求同比下行，叠加公司新项目建设、新工厂产能爬坡等因素共同影响。分业务来看，报告期内公司 PCB、封装基板业务营业收入及毛利率同比均有所下降；电子装联业务持续加大对下游市场的开发与深耕，叠加业务结构变化影响，营业收入同比实 </p>

现增长、毛利率同比下降。

在上半年经营承压的背景下，公司积极应对外部环境带来的挑战，通过开发新客户、强化运营提升效率、严控费用等措施降低需求弱化带来的冲击，并坚定有序推进研发工作，在封装基板高阶产品领域取得技术突破。

Q2、请介绍公司 2023 年上半年封装基板业务在下游市场拓展情况。

公司封装基板业务产品覆盖种类广泛多样，包括模组类封装基板、存储类封装基板、应用处理器芯片封装基板等，主要应用于移动智能终端、服务器/存储等领域，覆盖了包括半导体垂直整合制造商、半导体设计商及半导体封测商等主要客户群，并与多家全球领先厂商建立了长期稳定的合作关系，在部分细分市场上拥有领先的竞争优势。目前，公司已成为内资最大的封装基板供应商、国内领先的处理器芯片封装基板供应商。

2023 年上半年，受全球半导体景气持续低迷，下游厂商去库存等因素影响，公司各类封装基板订单较去年同期均出现不同程度下滑。公司凭借自身广泛的 BT 类封装基板产品覆盖能力，积极导入新项目，开发新客户，特别在存储类、射频模组类、FC-CSP 类产品市场取得深耕成果，把握了今年第二季度封装基板领域局部出现的需求修复机会。同时，公司在 FC-BGA 封装基板的技术研发与客户认证方面均取得阶段性进展。

Q3、请介绍公司目前在 FC-BGA 封装基板技术研发与客户认证方面取得的进展。

公司 FC-BGA 封装基板中阶产品目前已在客户端顺利完成认证，部分中高阶产品已进入送样阶段，高阶产品技术研发顺利进入中后期阶段，现已初步建成高阶产品样品试产能力。

Q4、请介绍公司 2023 年上半年 PCB 业务在通信领域拓展情况。

公司 PCB 业务长期深耕通信领域，覆盖各类无线侧及有线侧通信 PCB 产品。2023 年上半年，国内通信市场需求未出现明显改善，海外通信市场需求受到局部地区 5G 建设项目进展延缓影响，公司通信领域订单规模同比略有下降。在市场环境带来的挑战下，公司凭借行业领先的技术与高效优质的服务，在现有客户群中实现订单份额稳中有升，并持续加大力度推进新客户开发工作。

Q5、请介绍公司 2023 年上半年 PCB 业务在数据中心领域拓展情况。

数据中心作为公司近年来新进入并重点拓展的领域之一，已对公司营收产生较大贡献，整体市场份额有待公司进一步拓展。公司已配合客户完成 EGS 平台用 PCB 样品研发并具备批量生产能力，现已逐步进入中小批量供应阶段。公司 AI 服务器相关 PCB 产品目前占比较低，对营收贡献相对有限。2023 年上半年，由于全球经济降温和 EGS 平台切换不断推迟，数据中心整体需求依旧承压，公司该领域 PCB 订单同比有所减少。2023 年第二季度以来，数据中心领域下游部分客户项目库存有所回补，公司将继续聚焦拓展客户并积极关注和把握 EGS 平台后续逐步切换带来的机会。

Q6、请介绍公司 2023 年上半年 PCB 业务在汽车电子领域拓展情况。

汽车电子是公司 PCB 业务重点拓展领域之一。公司以新能源和 ADAS 为主要聚焦方向，主要生产高频、HDI、刚挠、厚铜等产品，其中 ADAS 领域产品比重相对较高，应用于摄像头、雷达等设备，新能源领域产品主要集中于电池、电控层面。2023 年上半年，公司持续加大对汽车电子市场开发力度，积极把握新能源和 ADAS 方向带来的增长机会，前期导入的新客户定点项目需求已逐步释放，同时深度开发现有客户项目贡献增量订单，南通三期工厂产能爬坡顺利推进为订单导入提供产能支撑，汽车电子领域报告期内营收规模同比继续实现增长，占 PCB 整体营收比重有所提升。

Q7、请介绍公司 2023 年上半年电子装联业务在下游市场拓展情况。

公司电子装联业务属于 PCB 制造业务的下游环节，产品形态可分为 PCBA 板级、功能性模块、部分整机产品/系统总装等，业务主要聚焦通信及数据中心、医疗、汽车电子等领域。2023 年上半年，公司电子装联业务加大对医疗、数据中心、汽车等领域的开发与深耕，提升客户服务水平，分别在医疗领域提升了客户粘性及主要大客户处份额占比、在数据中心领域稳固与客户合作关系同时改善了自身盈利能力、在汽车电子领域增加客户数量并扩大项目覆盖，叠加公司在运营层面加强项目管理能力，促进电子装联业务整体附加值持续提升。

Q8、请介绍公司南通三期项目连线后产能爬坡进展。

公司南通三期工厂于 2021 年第四季度连线投产，2022 年底已实现单月盈利，目前产

	<p>能爬坡进展顺利，产能利用率达到五成以上。</p> <p>Q9、请介绍公司无锡基板二期工厂连线后产能爬坡进展。</p> <p>相较于常规 PCB 工厂，封装基板工厂需要构建起适应国际半导体产业链客户要求的生产、质量、经营等高效运营体系，产能爬坡周期较长。公司无锡基板二期工厂已于 2022 年 9 月下旬连线投产并进入产能爬坡阶段，产线能力得到持续验证与提升，目前产能利用率达到三成以上。</p> <p>Q10、请介绍公司广州封装基板项目的建设进展。</p> <p>公司广州封装基板项目共分两期建设，其中项目一期厂房及配套设施建设和机电安装工程已基本完工，生产设备已陆续进厂安装，预计将于 2023 年第四季度连线投产。</p> <p>Q11、请介绍公司近期原材料采购价格变化情况。</p> <p>公司主要原材料包括覆铜板、半固化片、铜箔、金盐、油墨等，涉及品类较多，2023 年以来原材料价格整体相对保持稳定。公司将持续关注国际市场铜等大宗商品价格变化，并与供应商及客户保持积极沟通。</p> <p>注：调研过程中公司严格遵照《信息披露管理制度》等规定，未出现未公开重大信息泄露等情况。</p>
附件清单	无
日期	2023 年 8 月 30 日